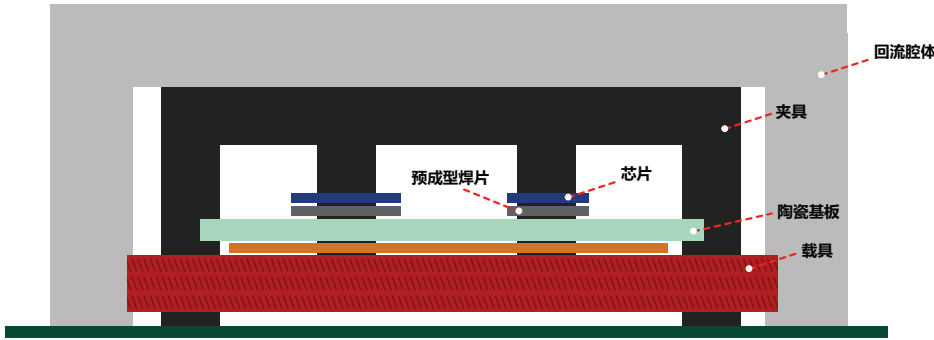


功率模块封装解决方案

挑战： 功率模块封装夹具

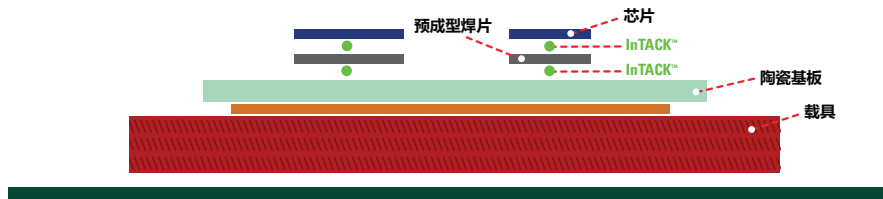


✗ 高精度贴装是长期可靠性和高一致性质量控制的保证

✗ 定制夹具的设计及维护成本昂贵，并增加回流工艺的复杂性



解决方案： InTACK™ 技术



- ✓ 无需工装夹具
- ✓ 简化回流工艺
- ✓ 减少回流时间
- ✓ 减少整体作业时间

✓ 高粘力材料使芯片、焊片在贴装和回流期间保持在原来的位置

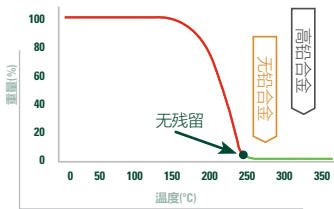


优点：

- ✓ 确保预成型焊片和芯片高精度贴装
- ✓ 粘力强和效果持久
- ✓ 在甲酸/真空回流效果最佳
- ✓ 对焊料润湿、空洞无影响
- ✓ 无需清洗或其它后续处理
- ✓ 通过点胶及工艺验证

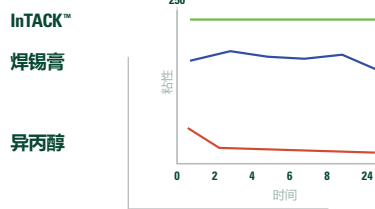
回流后无残留

无助焊剂焊接和烧结应用的理想选择



残留分析

随着时间的推移始终如一的高粘性强度



高粘性且作用时间长

InTACK™ 技术专为功率模块封装无助焊剂焊接、无残留的高质量焊接性能而设计。

有关详情: www.indiumchina.cn

From One Engineer To Another®

所有镭泰公司的焊锡膏和焊片工厂均获得了 IATF 16949:2016 认证
镭泰公司是 ISO 9001:2015 认证的公司

©2023 镭泰公司

表格编号: 99999 (SC A4) R0

